

2022-2028年中国IC设计 市场深度分析与投资潜力分析报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国IC设计市场深度分析与投资潜力分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202203/278477.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

集成电路设计（Integrated circuit design, IC design），亦可称之为超大规模集成电路设计（VLSI design），是指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计流程。集成电路设计涉及对电子器件（例如晶体管、电阻器、电容器等）、器件间互连线模型的建立。所有的器件和互连线都需安置在一块半导体衬底材料之上，这些组件通过半导体器件制造工艺（例如光刻等）安置在单一的硅衬底上，从而形成电路。2019年全球前十大IC设计公司（单位：百万美元）

排名

公司

股票代码

2019年营收

2018年营收

YOY

1

博通（Broadcom）

AVDL.O

17246

18547

-7.0%

2

高通（Qualcomm）

QCOM.O

14518

16370

-11.3%

3

英伟达（NVIDIA）

NVDA.O

10125

11163

-9.3%

4

联发科 (MediaTek.Inc)

2454.TW

7962

7882

1.0%

5

超威半导体 (AMD)

AMD.O

6731

6475

4.0%

6

赛灵思(XILINX)

XLNX.O

3236

2868

12.8%

7

迈威尔科技

MRVL.O

2708

2823

-4.1%

8

联咏 (Novatek)

3034.TW

2085

1813

15.0%

9

瑞昱半导体 (Realtek)

2379.TW

1965

1518

29.4%

10

戴乐格半导体(Dialog)

-

1421

1442

-1.5%

-

前十大合计

-

67997

70901

-4.1% 中企顾问网发布的《2022-2028年中国IC设计市场深度分析与投资潜力分析报告》共十章。首先介绍了中国IC设计行业市场发展环境、IC设计整体运行态势等，接着分析了中国IC设计行业市场运行的现状，然后介绍了IC设计市场竞争格局。随后，报告对IC设计做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国IC设计行业发展趋势与投资预测。您若想对IC设计产业有个系统的了解或者想投资中国IC设计行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 IC设计行业概述

第一节 IC设计行业特点

第二节 IC设计行业发展趋势

第二章 中国IC设计行业发展环境分析

第一节 经济环境分析

- 一、国民经济运行情况gdp
- 二、消费价格指数cpi、ppi
- 三、全国居民收入情况
- 四、恩格尔系数
- 五、工业发展形势
- 六、固定资产投资情况
- 七、财政收支状况
- 八、中国汇率调整

第二节 政策环境分析

- 一、行业政策影响分析
- 二、相关行业标准分析

第三节 IC设计行业社会环境分析

- 一、人口环境分析
- 二、教育环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、中国城镇化率
- 六、居民的各种消费观念和习惯

第四节 2019年中国IC设计行业技术环境分析

第三章 全球及中国IC设计市场

第一节 全球IC设计市场

第二节 台湾IC设计市场

第三节 中国大陆IC设计市场

一、中国IC设计市场概况

随着半导体制造环节向大陆转移，新建晶圆厂拉动半导体设备需求。2018年大陆地区首次超过台湾地区已成为全球第二大半导体设备市场，预计到2019年，大陆地区的设备销售额将达到173亿美元，超过韩国成为全球第一大半导体设备市场。大陆地区的IC设备销售额（十亿美元）

二、中国手机IC市场

三、中国智能卡IC市场

四、中国电源管理芯片市场

第四章 基础类IC设计企业

第一节 上海贝岭

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第二节 无锡华润微电子

一、公司简介

二、公司运营

三、发展战略

第三节 华微电子

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第四节 晶门科技

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第五节 北京君正集成电路股份有限公司

第六节 北京神州龙芯集成电路设计有限公司

第七节 苏州国芯科技有限公司

第五章 通讯类IC设计企业

第一节 国民技术

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第二节 锐迪科

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第三节 海思

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第四节 展讯

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第五节 联芯科技有限公司

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第六章 多媒体IC设计企业

第一节 中星微电子

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第二节 珠海炬力

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第三节 士兰微

一、公司简介

二、公司运营

三、公司战略

第四节 上海泰景

第五节 深圳芯邦

第六节 上海格科微

第七节 北京海尔

第八节 杭州国芯

第七章 智能卡IC设计企业

第一节 远望谷

一、企业基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第二节 上海复旦微电子

第三节 大唐微电子

第四节 上海华虹

第五节 北京同方微电子有限公司

第八章 其他类型IC设计企业

第一节 欧比特

一、企业基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第二节 福星晓程

一、企业基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第三节 长电科技

一、企业基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第四节 东软载波

一、企业基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第九章 2022-2028年中国IC设计发展前景预测

第一节 行业发展趋势预测

第二节 未来企业竞争格局

第三节 行业资源整合趋势

第四节 产业链竞争态势发展预测

第十章 2022-2028年中国IC设计行业投资机会与风险预警

第一节 投资环境的分析与对策（ ）

第二节 投资机遇分析

第三节 投资风险分析

一、政策风险

二、经营风险

三、技术风险

四、进入退出风险

第四节 投资策略与建议

一、企业资本结构选择

二、企业战略选择（ ）

三、投资区域选择

第五节 投资建议

图表目录：

图表：IC产业垂直分工演化过程

图表：IC设计在半导体产业链中的价值占比

图表：IC设计技术发展进程

图表：IC系统性能和集成度

图表：3c应用领域关键IC整合趋势

图表：人机接口关键半导体组件及主要供货商

图表：2019年全球25大IC设计商

图表：2015-2019年台湾IC设计产业产值

图表：2019年台湾IC设计产业前10大厂商营收及成长率

图表：2015-2019年中国IC设计产值变化趋势图

图表：中国IC市场应用结构

图表：2015至2019年国内手机出货量

更多图表请见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202203/278477.html>